

ДЕПАРТАМЕНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Е Р Е Ч Е Н Ь

КОРПУСОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

КНИГА 1

Перечень корпусов ЭКБ - 2021

Взамен Перечня корпусов ЭКБ-2020

Москва
АО «ЦКБ «Дейтон»
2022

**Перечень корпусов, разрешенных для применения при разработке, модернизации и производстве
электронной компонентной базы**

РАЗДЕЛ 1													
Условное обозначение корпуса	ОБОЗНАЧЕНИЕ технических условий, описания внешнего вида, чертежа корпуса	Отличи- тельный знак	Код предприятия- изготовителя / держателя подлинника КД	Основные технические характеристики									
				Размеры, мм				Особенности корпуса					
				габаритные размеры	МП	e	e1	металлизация на МП и ПО	располо- жение выводов	метод герме- тизации	связь МП с выво- дами	крыш- кой	
1 Корпуса интегральных микросхем													
1.1 Металлокерамические													
xxxxxxx	КГДФ.301176.036ТУ, УФ0.487.009Д1, КГДФ.301176.036-02СБ		1 / 1	D=10,0-0,2 E=7,2±0,2 A=4,9 макс.	5,1x2,9	2,5	7,5	МП: отсутствует ПО: отсутствует	ВБГ	сварка	-	-	
xxxxxxxx	КГДФ.301176.036ТУ, УФ0.487.009Д1, КГДФ.301176.036СБ		1 / 1	D=10,0-0,2 E=7,2±0,2 A=4,9 макс.	5,1x2,9	2,5	7,5	МП: отсутствует ПО: отсутствует	ВБГ	сварка	-	-	
xxxxxxxxxxx	КЮЯЛ.431419.013ТУ, КЮЯЛ.431419.013Д2, КЮЯЛ.431419.013СБ		3 / 3	D=10-0,2 E=7,2-0,2 A=3,1 макс.	3,4x5,6	2,5	7,5	МП: отсутствует ПО: отсутствует	ВБГ	сварка	-	-	